2026-2031年中国芯片行业市场需求与投资规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：芯片行业综述及数据来源说明
1.1 芯片行业界定
1.1.1 芯片的界定
1、定义
2、术语
1.1.2 芯片行业分类
1、按国际标准分类
2、按使用功能分类
3、芯片相似概念辨析
1.1.3《国民经济行业分类与代码》中芯片行业归属
1.1.4 芯片行业监管体系及机构介绍
1、中国芯片行业主管部门
2、中国芯片行业自律组织
1.1.5 中国芯片行业标准体系建设现状
1、中国芯片行业标准体系建设
2、中国芯片行业现行标准分析
（1）中国芯片行业现行国家标准汇总
（2）中国芯片行业现行行业标准汇总
（3）中国芯片行业现行地方标准汇总
（4）中国芯片行业现行企业标准汇总
（5）中国芯片行业现行团体标准汇总
3、中国芯片行业重点标准解读
1.2 芯片产业画像
1.2.1 芯片产业链结构梳理
1.2.2 芯片产业链生态图谱
1.2.3 芯片产业链区域热力图
1.3 本报告数据来源及统计标准说明
1.3.1 本报告研究范围界定说明
1.3.2 本报告权威数据来源
1.3.3 本报告研究方法及统计标准说明
——现状篇——
第2章：全球芯片行业发展状况分析
2.1 全球芯片行业发展历程
2.2 全球芯片行业市场规模体量
2.3.1 全球半导体行业市场规模
2.3.2 全球芯片行业市场规模
2.3 全球芯片市场发展现状分析
2.2.1 全球芯片市场供给现状
2.2.2 全球芯片市场需求现状
2.2.3 全球芯片市场发展特点
2.4 全球芯片行业市场竞争格局
2.5 全球芯片行业区域发展格局及重点区域市场研究
2.5.1 全球芯片行业区域发展格局
2.5.2 重点区域一：美国芯片行业市场分析
1、美国芯片市场规模
2、美国芯片技术研发进展
2.5.3 重点区域二：韩国芯片行业市场分析
1、韩国芯片市场规模
2、韩国芯片技术研发进展
2.6 全球芯片行业发展趋势预判及市场前景预测

2.6.1 中美贸易战对全球芯片行业发展影响分析
1、中美贸易战对全球芯片行业供应链结构产生的影响
2、中美贸易战对全球芯片价值链重构产生的影响
2.6.2 全球芯片行业发展趋势预判
2.6.3 全球芯片行业市场前景预测
第3章：中国芯片行业发展状况分析
3.1 中国芯片行业发展综述
3.1.1 中国芯片产业发展历程
3.1.2 中国芯片行业发展地位
3.2 中国芯片行业市场规模（除港澳台）
3.3 中国芯片行业市场主体
3.2.1 芯片市场主体类型
3.2.2 芯片企业进场方式
3.2.3 芯片新注册企业
3.2.4 芯片在业/存续企业
1、芯片行业企业注册资本分布
2、芯片行业注册企业省市分布
3、芯片行业在业/存续企业类型分布
3.4 中国芯片行业经营模式
3.5 中国芯片市场供给情况
3.4.1 中国芯片产能现状
3.4.2 中国芯片产量现状
3.6 中国芯片行业需求情况
3.7 中国芯片产业进出口贸易情况
3.6.1 中国集成电路（芯片）行业进出口贸易概况
3.6.2 中国集成电路（芯片）行业进口贸易状况
1、集成电路（芯片）行业进口贸易规模
2、集成电路（芯片）行业进口价格水平
3、集成电路（芯片）行业进口产品结构
4、集成电路（芯片）行业进口来源地
3.6.3 中国集成电路（芯片）行业出口贸易状况
1、集成电路（芯片）行业出口贸易规模
2、集成电路（芯片）行业出口价格水平
3、集成电路（芯片）行业出口产品结构
4、集成电路（芯片）行业出口目的地
3.6.4 中国集成电路（芯片）行业进出口贸易影响因素及发展趋势
3.8 中国芯片产业痛点与应对策略
3.8.1 中国芯片产业痛点分析
3.8.2 中国芯片产业痛点应对策略
第4章：中国芯片行业竞争及投融资
4.1 中国芯片行业竞争态势
4.1.1 芯片领先企业成功关键因素（KSF）
4.1.2 芯片竞争者入场动因
4.1.3 芯片竞争者入场进程
4.1.4 芯片竞争者集群/梯队
4.2 中国芯片行业市场竞争程度
4.2.1 芯片行业市场集中度
4.2.2 芯片行业波特五力分析
4.3 中国芯片行业企业竞争格局
4.4 中国芯片领先企业核心竞争力解构
4.4.1 芯片企业竞争路线/焦点汇总
4.4.2 芯片领先企业竞争力雷达图
4.5 中国芯片行业国家投资水平
4.6 中国芯片行业投融资动态及热门赛道
4.6.1 芯片行业融资动态
1、资金来源
2、融资事件
3、融资规模
4、融资轮次

5、热门融资赛道
6、热门融资地区
4.6.2 芯片行业对外投资
4.7 芯片行业兼并重组动态
4.7.1 兼并重组阶段、方式及动因
4.7.2 兼并重组事件
4.7.3 兼并重组案例
4.7.4 兼并重组趋势
4.8 中国芯片企业IPO动态
4.8.1 中国芯片行业IPO企业汇总
4.8.2 IPO募资规模
4.8.3 IPO板块分布
4.8.4 IPO企业地域分布
4.8.5 行业IPO展望
4.9 芯片海外企业在华市场竞争
4.9.1 海外企业在华市场竞争策略
4.9.2 海外企业在华市场竞争力评价
4.10 中国芯片企业全球化布局及竞争力
4.10.1 中国芯片企业出海/全球化布局
4.10.2 中国芯片企业在全球市场竞争力评价
4.10.3 中国芯片企业全球化布局策略
4.11 中国芯片行业国产替代布局状况
4.11.1 中国芯片行业在行业不同环节的国产化替代情况
4.11.2 中国芯片行业在不同细分领域的国产化替代情况
第5章：中国芯片领域细分行业分析
5.1 中国芯片设计行业发展分析
5.1.1 中国芯片设计行业发展历程
5.1.2 中国芯片设计行业市场现状
1、企业数量
2、市场规模
5.1.3 中国芯片设计行业竞争格局
5.2 中国芯片制造行业发展分析
5.2.1 芯片技术现状
5.2.2 中国芯片制造市场现状
1、晶圆代工产能规模
2、市场规模
5.2.3 中国晶圆制造行业竞争格局
5.3 中国芯片封测行业发展分析
5.3.1 芯片封测技术
1、芯片封装技术简介
2、芯片测试技术简介
5.3.2 中国芯片封测行业市场现状
1、主要企业产量
2、市场规模
5.3.3 中国芯片封测行业竞争格局
第6章：中国芯片行业细分产品分析
6.1 芯片行业产品结构概况
6.1.1 芯片产品类型介绍
6.1.2 芯片产品结构分析
6.2 中国模拟芯片市场分析
6.2.1 模拟芯片概况
1、模拟芯片概况
2、模拟芯片分类
6.2.2 模拟芯片市场规模
1、全球模拟芯片市场规模
2、中国模拟芯片市场规模
6.2.3 模拟芯片市场竞争格局
1、全球模拟芯片竞争格局
2、中国模拟芯片竞争格局

6.2.4 模拟芯片的下游应用
6.3 中国微处理器市场分析
6.3.1 微处理器分类
6.3.2 微处理器市场规模
1、全球微处理器市场规模
2、中国微处理器市场规模
6.3.3 微处理器市场竞争格局
1、全球微处理器的竞争格局
2、中国微处理器的竞争格局
6.3.4 微处理器的下游应用
6.4 中国逻辑芯片市场分析
6.4.1 逻辑芯片分类
6.4.2 逻辑芯片市场规模
1、全球逻辑芯片市场规模
2、中国逻辑芯片市场规模
6.4.3 逻辑芯片市场竞争格局
1、计算机处理器（CPU）市场竞争格局
2、计算机图形处理器（GPU）市场竞争格局
6.4.4 逻辑芯片的下游应用
6.5 中国存储芯片市场分析
6.5.1 存储芯片分类
6.5.2 存储芯片市场规模
1、全球存储芯片市场规模
2、中国存储芯片市场规模
6.5.3 存储芯片市场竞争格局
1、细分产品竞争格局
2、企业竞争格局
6.5.4 存储器的下游应用
6.6 中国芯片行业未来细分产品——量子芯片发展进程分析
6.6.1 量子芯片概述
6.6.2 产品发展历程
6.6.3 市场发展形势
6.6.4 产品研发动态
第7章：中国芯片供应链分析
7.1 中国芯片原材料市场分析
7.1.1 芯片原材料概述
7.1.2 中国半导体材料市场分析
7.1.3 中国硅片市场分析
7.1.4 中国光刻胶市场分析
7.1.5 中国CMP抛光液市场分析
7.1.6 中国芯片原材料发展趋势
7.2 中国芯片关键设备市场分析
7.2.1 芯片关键设备概述
7.2.2 中国半导体设备市场分析
7.2.3 中国光刻机市场分析
7.2.4 中国刻蚀设备市场分析
7.2.5 中国薄膜沉积设备市场分析
7.2.6 中国芯片核心设备发展趋势
7.3 中国芯片其他相关配套产业市场分析
7.3.1 中国芯片算法市场分析
7.3.2 中国芯片IP分析
7.3.3 中国芯片EDA工具分析
7.4 配套产业布局对芯片行业的影响总结
第8章：中国芯片下游应用市场分析
8.1 中国5G芯片发展现状
8.1.1 5G产业发展背景
8.1.2 5G芯片市场发展现状
8.1.3 5G芯片市场竞争格局
8.1.4 5G芯片发展趋势

8.2 中国自动驾驶芯片发展现状
8.2.1 自动驾驶行业发展背景
8.2.2 自动驾驶芯片市场发展现状
8.2.3 自动驾驶芯片市场竞争格局
8.2.4 自动驾驶芯片发展前景
8.3 中国AI芯片发展现状
8.3.1 AI产业发展背景
8.3.2 AI芯片市场发展现状
8.3.3 AI芯片市场竞争格局
8.3.4 AI芯片发展趋势
8.4 中国智能穿戴设备芯片发展现状
8.4.1 智能穿戴设备行业发展背景
8.4.2 智能穿戴设备芯片市场发展现状
8.4.3 智能穿戴设备芯片市场竞争格局
8.4.4 智能穿戴设备芯片发展趋势
8.5 中国智能手机芯片发展现状
8.5.1 智能手机行业发展背景
8.5.2 智能手机芯片市场发展现状
8.5.3 智能手机芯片市场竞争格局
8.5.4 智能手机芯片发展趋势
8.6 中国服务器芯片发展现状
8.6.1 服务器行业发展背景
8.6.2 服务器芯片市场发展现状
8.6.3 服务器芯片市场竞争格局
8.6.4 服务器芯片发展趋势
8.7 中国个人计算机芯片发展现状
8.7.1 个人计算机行业发展背景
8.7.2 个人计算机芯片市场发展现状
1、计算机CPU芯片发展现状
2、计算机GPU芯片发展现状
8.7.3 个人计算机芯片市场竞争格局
1、计算机CPU芯片竞争格局
2、计算机GPU芯片竞争格局
8.7.4 个人计算机芯片发展趋势
第9章：中国芯片产业区域发展格局解读
9.1 中国芯片行业区域发展格局
9.1.1 中国芯片行业企业区域分布
9.1.2 中国芯片行业产量区域分布
9.2 中国芯片产业集群/园区建设现状
9.3 重点区域发展状况：深圳
9.3.1 芯片行业发展环境
9.3.2 芯片行业发展现状
1、芯片行业企业数量
2、芯片行业市场规模
9.3.3 芯片行业细分领域现状
1、IC设计环节
2、IC制造环节
3、IC封测环节
9.3.4 芯片行业发展趋势
9.4 重点区域发展状况：上海
9.4.1 芯片行业发展环境
9.4.2 芯片行业发展现状
1、芯片行业企业数量
2、芯片行业市场规模
9.4.3 芯片行业细分领域现状
1、IC设计环节
2、IC制造环节
3、IC封测环节
9.4.4 芯片行业发展趋势

9.5 重点区域发展状况：台湾
9.5.1 芯片行业发展环境
9.5.2 芯片行业发展现状
1、芯片行业市场规模
9.5.3 芯片行业细分领域现状
1、IC设计环节
2、IC制造环节
3、IC封测环节
9.5.4 芯片技术研发进展
9.5.5 芯片行业发展趋势
第10章：全球及中国芯片企业案例解析
10.1 芯片综合型企业案例分析
10.1.1 英特尔
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、技术工艺开发
5、未来发展战略
10.1.2 三星
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、芯片业务发展
5、技术工艺开发
6、未来发展战略
10.1.3 高通公司
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业业务结构
4、技术工艺开发
5、未来发展战略
10.1.4 英伟达
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业业务结构
4、技术工艺开发
5、未来发展战略
10.1.5 AMD
1、企业发展概况
2、经营效益分析
3、企业业务结构
4、技术工艺开发
5、未来发展战略
10.1.6 SK海力士
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、芯片行业发展
5、未来发展战略
10.1.7 德州仪器
1、企业发展概况
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、企业区域分布
5、未来发展战略
10.1.8 联发科技
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业产品结构

4、技术工艺开发
5、未来发展战略
10.2 芯片设计重点企业案例分析
10.2.1 海思
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、技术工艺开发
5、最新发展动态
10.2.2 博通有限公司
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、收购动态分析
10.2.3 Marvell
1、企业发展概况
2、经营效益分析
3、企业产品结构
4、未来发展战略
10.2.4 紫光展锐
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、产品研发进展
4、发展动态分析
10.3 晶圆代工重点企业案例分析
10.3.1 台积电
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、公司晶圆代工业务
4、产品研发进展
5、技术工艺开发
6、企业发展战略
10.3.2 格芯
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、晶圆代工业务
4、技术工艺开发
5、企业发展战略
10.3.3 联电
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、晶圆代工业务
4、技术工艺开发
5、未来发展战略
10.3.4 力积电
1、企业基本信息
2、经营效益分析
3、晶圆代工业务
4、技术工艺开发
10.3.5 中芯国际
1、企业基本信息
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业晶圆代工业务分析
5、企业技术水平分析
6、企业营销网络分析
7、企业发展战略
10.3.6 华虹
1、企业基本信息

2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业营销网络分析
5、企业技术水平分析
10.4 芯片封测重点企业案例分析
10.4.1 Amkor
1、企业发展简介
2、经营效益分析
3、企业销售区域分布
4、企业在中国市场投资布局情况
10.4.2 日月光
1、企业发展简介
2、企业财务情况分析
3、企业主营产品及应用领域
4、企业产能布局
10.4.3 南茂
1、企业发展概况
2、经营效益分析
3、企业业务结构
4、企业营销网络分析
10.4.4 长电科技
1、企业基本信息
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业营销网络分析
5、企业技术水平分析
10.4.5 天水华天
1、企业基本信息
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业技术水平分析
5、企业营销网络分析
10.4.6 通富微电
1、企业基本信息
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业产能布局及营销网络分析
——展望篇——
第11章：中国芯片行业政策环境洞察&发展潜力
11.1 中国芯片行业政策汇总解读
11.1.1 国家层面芯片行业政策规划汇总及解读
11.1.2 国家层面重点政策对芯片行业发展的影响分析
1、工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》对芯片行业发展的影响
2、《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》对芯片行业发展的影响
11.1.3 中国芯片行业区域政策热力图
11.1.4 中国芯片产业各省市政策汇总及解读
1、中国芯片产业各省市重点政策汇总
2、中国各省市芯片行业发展目标解读
11.1.5 政策环境对行业发展的影响分析
11.2 中国芯片行业PEST环境分析
11.2.1 中国芯片行业经济（Economy）环境分析
1、中国宏观经济发展现状
（1）中国GDP及增长情况
（2）中国三次产业结构
（3）中国工业经济增长情况
2、中国宏观经济发展展望
（1）国际机构对中国GDP增速预测
（2）国内机构对中国宏观经济指标增速预测

3、中国芯片行业发展与宏观经济相关性分析
11.2.2 中国芯片行业社会（Social）环境分析
1、中国人口规模及增速
2、中国城镇化水平变化
（1）中国城镇化现状
（2）中国城镇化趋势展望
3、中国劳动力人数及人力成本
（1）中国劳动力供给形式严峻
（2）中国人力成本持续上升
4、社会环境对芯片行业的影响总结
11.2.3 中国芯片行业技术（Technology）环境分析
1、中国芯片研发投入&产出
（1）中国芯片研发投入情况
（2）中国芯片科研产出-文献
（3）中国芯片科研产出-专利
（4）中国芯片技术创新动态
2、中国芯片行业技术工艺及流程
3、中国芯片技术路线图/全景图
4、中国芯片技术布局动态
（1）技术创新主流模式
（2）关键核心技术
（3）新兴技术融合发展
（4）技术研发方向/趋势
5、技术环境对中国芯片行业发展的影响总结
11.3 中国芯片行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）
11.4 中国芯片行业发展潜力评估
11.5 中国芯片行业未来关键增长点
11.5.1 细分产品关键增长点
1、人工智能芯片
2、边缘计算芯片
3、量子计算芯片
4、物联网芯片
5、高性能计算芯片
11.5.2 下游应用关键增长点
1、通信领域
2、工业控制
3、汽车电子
11.5.3 政策规划下的关键增长点
11.6 中国芯片行业发展前景预测
11.6.1 芯片总体前景预测
11.6.2 芯片细分领域前景预测
11.7 中国芯片行业发展趋势洞悉
11.7.1 芯片行业技术发展趋势
11.7.2 行业产品发展趋势预测
11.7.3 行业市场竞争趋势预测
第12章：中国芯片行业投资战略规划策略及建议
12.1 中国芯片行业进入与退出壁垒
12.1.1 进入壁垒
1、技术壁垒
2、人才壁垒
3、资金实力壁垒
4、产业化壁垒
5、客户维护壁垒
12.1.2 退出壁垒
12.2 中国芯片行业投资风险预警
12.2.1 风险预警
1、政策风险
2、宏观经济风险
3、供求风险

4、其他风险
12.2.2 风险应对
12.3 中国芯片行业投资机会分析
12.3.1 芯片产业链薄弱环节投资机会
12.3.2 芯片行业细分领域投资机会
1、自动驾驶
2、卫星通话终端
12.3.3 芯片行业区域市场投资机会
12.3.4 芯片产业空白点投资机会
1、光刻机技术
2、芯片的存算一体化发展
12.4 中国芯片行业投资价值评估
12.4.1 芯片行业发展空间较大
12.4.2 芯片行业政策扶持利好
12.4.3 芯片下游应用市场增长迅速
12.5 中国芯片行业投资策略建议
12.6 中国芯片行业可持续发展建议
12.6.1 加强政策支持力度
12.6.2 强化人才培养机制
12.6.3 坚持技术创新

图表目录

图表1：芯片示意图
图表2：芯片专业术语说明
图表3：按电路对芯片进行分类
图表4：不同功能的芯片介绍
图表5：《国民经济行业分类（2017版）》中芯片行业所归属类别
图表6：中国芯片行业监管体系构成
图表7：中国芯片行业主管部门
图表8：中国芯片行业自律组织
图表9：截至2025年中国芯片行业标准体系建设（单位：项）
图表10：截至2025年中国芯片行业代表性现行国家标准
图表11：截至2025年中国芯片行业的行业标准
图表12：截至2025年中国芯片行业代表性地方标准
图表13：2018-2025年发布的中国芯片行业的企业标准
图表14：截至2025年中国芯片行业的团体标准
图表15：中国芯片行业重点标准解读
图表16：芯片产业链结构梳理
图表17：芯片产业链生态图谱
图表18：芯片产业链区域热力图
图表19：本报告研究范围界定
图表20：本报告权威数据资料来源汇总
图表21：本报告的主要研究方法及统计标准说明
图表22：全球芯片行业发展历程
图表23：2019-2025年全球半导体市场规模及增速（单位：亿美元，%）
图表24：2025年全球半导体细分产品结构（单位：亿美元，%）
图表25：2019-2025年全球集成电路（芯片）市场规模（单位：亿美元，%）
图表26：2025年全球芯片细分产品结构（单位：亿美元，%）
图表27：2021-2025年全球芯片产能（单位：亿片，%）
图表28：2019-2025年全球芯片出货量（单位：亿片，%）
图表29：全球芯片市场特点分析
图表30：2022-2025年全球主要芯片厂商业务收入排名（单位：亿美元，%）
图表31：2025年全球集成电路（芯片）区域市场分布（按企业所在地营收份额）（单位：%）
图表32：2019-2025年美国半导体及芯片市场规模（单位：亿美元）
图表33：2019-2025年韩国芯片及半导体行业市场规模（单位：亿美元，%）

图表34：全球芯片行业发展趋势预判
图表35：2026-2031年全球芯片行业市场规模预测（单位：亿美元）
图表36：中国芯片行业历程
图表37：2020-2025年中国数字经济规模占GDP比重（单位：%）
图表38：2015-2025年中国集成电路（芯片）市场销售额（单位：亿元，%）
图表39：2017-2025年中国集成电路（芯片）各领域市场结构（单位：%）
图表40：中国芯片行业主体构成
图表41：中国芯片行业主体构成
图表42：2021-2025年中国芯片市场主体数量（单位：家）
图表43：截至2025年中国芯片企业注册资本分布（单位：家）
图表44：截至2025年中国芯片企业省市分布（单位：家，%）
图表45：截至2025年中国芯片市场在业/存续企业类型分布（单位：家，%）
图表46：半导体产业链及业务模式
图表47：垂直分工商业模式
图表48：Foundry（代工厂）模式分析
图表49：IDM（Integrated Device Manufacture）模式分析
图表50：Fabless（无工厂芯片供应商）模式分析
图表51：2023-2025年中国芯片行业代表性厂商产能产量情况
图表52：2015-2025年中国集成电路（芯片）产量（单位：亿块，%）
图表53：2025年中国芯片行业代表性企业营收与销量情况（单位：亿元，亿片）
图表54：中国集成电路（芯片）行业进出口商品名称及HS编码
图表55：2020-2025年中国集成电路（芯片）行业进出口贸易概况（单位：亿元）
图表56：2020-2025年中国集成电路（芯片）行业进口贸易状况（单位：亿个，亿元）
图表57：2020-2025年中国集成电路（芯片）行业进口价格水平（单位：元/个）
图表58：2025年中国集成电路（芯片）行业进口产品结构（单位：%）
图表59：2025年中国集成电路（芯片）行业进口来源地情况（按金额统计）（单位：%）
图表60：2020-2025年中国集成电路（芯片）行业出口贸易状况（单位：亿个，亿元）
图表61：2020-2025年中国集成电路（芯片）行业出口价格水平（单位：元/个）
图表62：2025年中国集成电路（芯片）行业出口产品结构（单位：%）
图表63：2025年中国集成电路（芯片）行业出口目的地情况（按金额）（单位：%）
图表64：中国集成电路（芯片）行业进出口贸易影响因素及发展趋势分析
图表65：中国芯片产业痛点梳理
图表66：中国芯片产业应对策略
图表67：中国芯片行业领先企业成功关键因素分析
图表68：中国代表性芯片行业竞争者入场进程
图表69：中国芯片行业竞争者集群
图表70：2025年中国芯片行业市场集中度（单位：%）
图表71：芯片行业波特五力模型分析
图表72：2025年中国芯片行业代表性企业竞争分析（单位：亿元，亿片，%）
图表73：芯片企业竞争路线/焦点汇总
图表74：中国芯片行业领先企业竞争力雷达图
图表75：芯片产业基金投资动向统计（单位：%）
图表76：国家芯片产业基金一期部分重点投资企业汇总
图表77：国家芯片产业基金二期部分重点投资企业汇总
图表78：中国芯片行业资金来源
图表79：中国芯片行业重要资金来源解读
图表80：2025年中国芯片行业投融资事件汇总（单位：元）
图表81：2014-2025年中国芯片行业融资规模（单位：起，亿元）
图表82：截至2025年芯片行业融资轮次（单位：起，%）
图表83：截至2025年中国芯片行业热门融资赛道（单位：起，%）
图表84：截至2025年芯片行业热门融资地区（单位：起，%）
图表85：2023-2025年中国芯片企业代表性投资事件/项目
图表86：芯片行业兼并重组阶段、方式及动因
图表87：2025年兼并与重组事件汇总（单位：万元）
图表88：2023-2025年中国芯片行业IPO企业汇总（单位：元）
图表89：2016-2025年中国芯片行业IPO规模情况（单位：家，亿元）
图表90：2016-2025年中国芯片行业IPO板块分布情况（单位：家，%）
图表91：2016-2025年中国芯片行业IPO企业区域分布情况（单位：家，%）
图表92：中国芯片行业IPO展望

图表93：海外企业在中国的竞争策略分析
图表94：海外企业在华市场竞争力评价
图表95：中国芯片企业全球化布局策略
图表96：中国芯片行业在行业不同环节的国产化替代情况
图表97：中国芯片行业在不同细分领域的国产化替代情况
图表98：2016-2025年中国IC设计行业企业数量（单位：家）
图表99：2017-2025年中国芯片设计业销售额（单位：亿元，%）
图表100：2020-2025年国内TOP10芯片设计企业上榜门槛（单位：亿元）
图表101：2025年中国芯片设计公司TOP20（Fabless+IDM）
图表102：晶圆加工及芯片生产主要涉及工艺流程
图表103：2025年中国晶圆产能规划（单位：%）
图表104：2017-2025年中国集成电路（芯片）制造业销售额（单位：亿元，%）
图表105：2025年中国大陆代表性晶圆代工厂营收和市占率（单位：亿美元，%）
图表106：芯片常用封装工艺
图表107：器件开发阶段的测试
图表108：制造阶段的测试
图表109：主要测试工艺种类
图表110：主要测试项目种类
图表111：2021-2025年中国芯片封装测试行业主要企业产量（单位：亿支）
图表112：2017-2025年中国集成电路（芯片）封测业销售额（单位：亿元，%）
图表113：中国集成电路（芯片）封装测试行业企业类别
图表114：2025年全球委外封测（OSAT）市场占有率（单位：%）
图表115：国内封测厂商与行业领先封测厂商主要技术对比
图表116：芯片产品分类简析
图表117：2025年中国芯片市场细分产品结构（单位：%）
图表118：模拟芯片分类
图表119：2018-2025年全球模拟芯片市场规模（单位：亿美元，%）
图表120：2020-2025年中国模拟芯片市场规模（单位：亿元，%）
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！